

⚠ 사용시 주의사항

- 천공작업은 항상 서있는 자세에서 하며 천공핀이 종이의 끝부분까지 뚫을 수 있도록 손잡이를 힘있게 끝까지 내려 누른다.
- 천공작업 전에 서류에 금속부착물(스테플러 등)을 완전히 제거한 후 사용하여야 하며 그렇지 않은 경우 천공침이 파손될 수가 있다.
- 손잡이는 서류의 거치나 테이블의 이동시에 항상 상단 끝까지 올린 상태에서 사용하여야 한다.
그리고 테이블의 이동도 항상 천천히 부드럽게 하여야 한다.
- 천공침이 매우 날카로우므로 작업시 손가락이 천공침 주위에 있지 않도록 주의하여야 한다.
- 다음과 같은 정기적인 관리사항을 준수하여야 한다.
 - 천공작업이 원활치 않을 경우 천공침, 천공패드를 교체한다.
 - 천공작업시 천공패드를 수시로 회전시켜 사용한다.
 - 테이블 위의 천공침을 제거해 주어야 한다.

<품질보증서>

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 공정관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
2. 제품의 편리한 사용과 수명연장을 위하여 본 사용설명서를 필히 읽어 보신 후 사용하시기 바랍니다.
3. 만약 구입일로부터 1년 이내에 정상적인 사용에 있어 제조상의 책임에 대한 고장에 대하여 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 하여 드릴것을 보증합니다.
4. 다음의 경우에는 보증기간 이내라도 실비의 부품대를 받고 수리하여 드립니다.

- 보증서를 제시하지 않은 경우
- 소모품의 경우 - 천공침, 천공패드
- 사용자의 잘못으로 본 상품 취급 대리점 이외에서 수리개조에 의한 고장 및 이상인 경우
- 화재, 수해, 기타 천재지변 등 불가항력에 대한 고장 및 이상인 경우

 **현대오피스(주)**

www.hd2.co.kr 대표전화 1566-3445

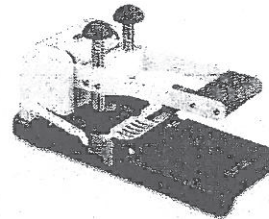
SPC

SPC Co., Ltd.

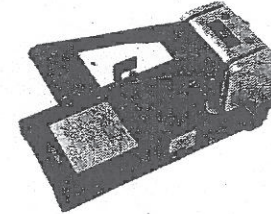
사용 설명서

강력 2공 천공제본기

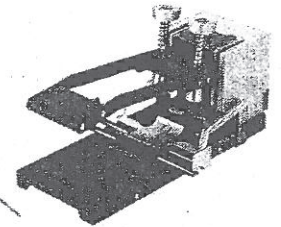
모델명 : DUO-35/20 (70/80mm 겸용)
DUO-N35/N20 (70mm)
DP-200 (70mm)



DUO-20/N20



DP-200



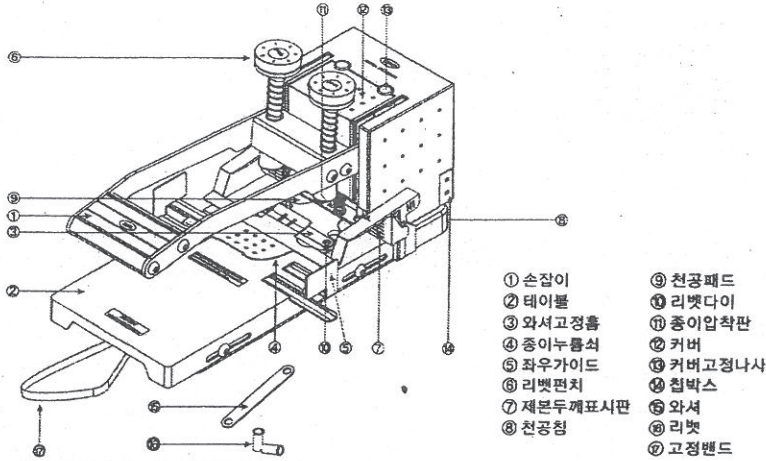
DUO-35/N35

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • DUO-20/N20, DP-200 | • DUO-35/N35 |
| • 천공 제본능력 : 200매/1회 | • 천공 제본능력 : 350매/1회 |
| • 천공구멍의 직경 : 6mm | • 천공구멍의 직경 : 6mm |
| • 천공구멍의 간격 | • 천공구멍의 간격 |
| - DUO-20 : 70/80mm 겸용 | - DUO-35 : 70/80mm 겸용 |
| - DUO-N20 : 70mm | - DUO-N35 : 70mm |
| - DP-200 : 70mm (제본기능 없음) | |

 **현대오피스(주)**

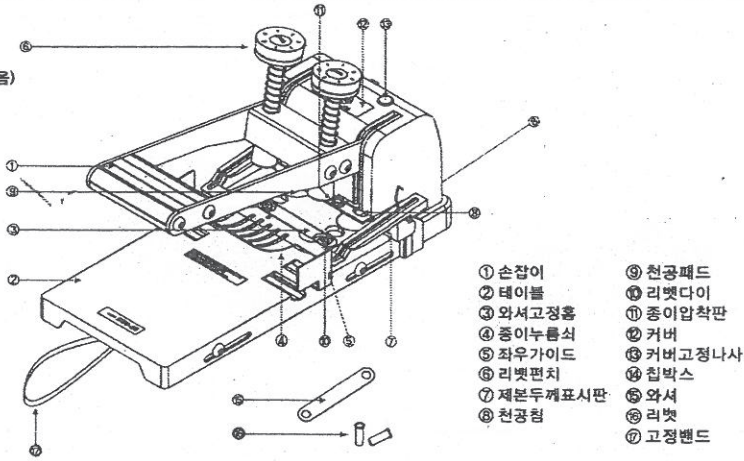
1. 각부의 명칭

1) 모델명 : DUO-35/N35



- ① 손잡이
- ② 테이블
- ③ 와셔고정용
- ④ 종이누름쇠
- ⑤ 좌우가이드
- ⑥ 리벳핀치
- ⑦ 제본두께표시판
- ⑧ 천공침
- ⑨ 천공패드
- ⑩ 리벳다이
- ⑪ 종이압착판
- ⑫ 커버
- ⑬ 커버고정나사
- ⑭ 칩박스
- ⑮ 와셔
- ⑯ 리벳
- ⑰ 고정밴드

2) 모델명 : DUO-20/N20
DP-200 (제본기능 없음)

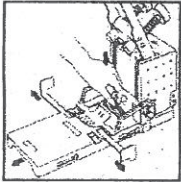


- ① 손잡이
- ② 테이블
- ③ 와셔고정용
- ④ 종이누름쇠
- ⑤ 좌우가이드
- ⑥ 리벳핀치
- ⑦ 제본두께표시판
- ⑧ 천공침
- ⑨ 천공패드
- ⑩ 리벳다이
- ⑪ 종이압착판
- ⑫ 커버
- ⑬ 커버고정나사
- ⑭ 칩박스
- ⑮ 와셔
- ⑯ 리벳
- ⑰ 고정밴드

※ 기계의 구조와 사양은 성능의 개선을 위해 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

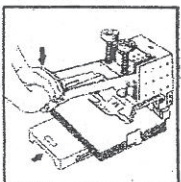
2. 사용방법 (DUO-35/N35, DUO-20/N20, DP-200 사용법은 동일합니다)

1) 와셔거치



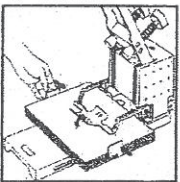
- 손잡이(①)를 눌러서 들어 올린다.
- 테이블을 왼쪽으로 당긴 후 와셔를 와셔의 고정홈에 놓는다. 경우에 따라서 와셔를 놓지 않고 사용할 수도 있다.

3) 천공작업

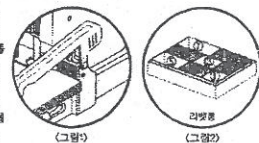


- 서류 정렬이 된 후 테이블을 끝까지 밀어 넣는다. 그리고 선 자세에서 손잡이를 위에서 고정홈에 걸어서 내려 누른다. 이때 일측 손바닥을 손잡이에 밀착 시킨 후 양팔을 매서 상체의 무게로 누르면 보다 쉬운 천공작업이 가능하다.

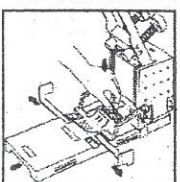
2) 서류정렬



- 천공 및 제본용 서류를 가지런히 정돈한 후 테이블에 부착된 종이 누름(④)을 눌러서 들어 올린 후 서류를 테이블의 안쪽 끝에 밀착시킨다. 그리고 좌우가이드(⑤)를 서류의 양쪽면에 밀착시킨다. 이때 좌우 가이드는 자동으로 서류의 중앙에 천공이 되도록 작동한다.

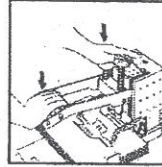


4)와셔 및 리벳거치



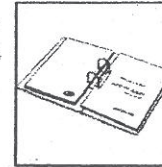
- 천공작업이 끝난 후 손잡이를 끝까지 들어 올린다.
- 테이블을 부드럽게 왼쪽으로 돌려서 잡아당긴 후 서류의 두께를 측정하여 알맞은 리벳(⑯)을 리벳통에서 선정한 후 와셔(⑮)와 함께 리벳을 정중선 서류의 구멍에 밀어 넣는다.
- 서류의 두께에 적합한 리벳(선정시 좌측 그림1과 같이 테이블 왼쪽에 부착된 제본두께 표시판(⑦)의 서류를 누른 후 이때 서류 뒷면에 나타나는 표시판의 숫자가 알맞은 리벳의 규격으로 이 규격의 리벳을 그리고 같이 리벳통에서 선택하면 된다.

5) 제본(리벳팅)작업



- 와셔 및 리벳의 거치 후 손잡이를 수평이 되도록 내린 상태에서 한손으로 좌 - 우의 리벳핀치(⑥)를 차례로 지긋이 눌러준 후 재차 리벳핀치를 세게 치면 멋있고 견고한 제본이 된다.

6) 화일링



- 제본된 서류를 화일에 보관할 수도 있다.
- 화일의 종류(70, 80mm)에 따라 천공간격을 제조할 경우에는 화일의 권리요령을 참조하여 간격을 조정하면 된다.

7) 4공 천공·제본



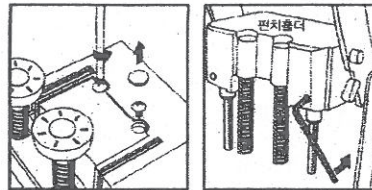
- 좌우가이드(⑤)를 좌우로 끝까지 밀면 후 서류를 좌측가이드에 밀착시켜 천공 및 제본한 후 우측 가이드에 밀착시켜 천공제본하면 좌측 그림과 같이 4공 천공제본도 가능하다.

3. 유지 및 관리방법

1) 천공침 교체방법

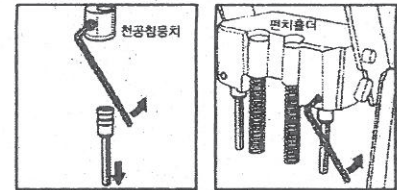
- 천공작업이 힘들게 되거나 천공침이 파손된 경우 아래 그림과 같이 새것으로 교체하여야 한다.

(적용모델: DUO-N35/N20, DP-200)



- 커버 뒷부분의 고무캡을 손으로 빼낸 후 나사를 드라이버로 해제한다.
- 펀치홀더의 전면부에 있는 나사를 육각렌치로 돌려 풀면 천공침이 해제된다.
- 침교체를 육각렌치는 우측그림과 같이 칩박스의 안쪽에 고정되어 있으므로 사용 후 팔이 권위처에 고정시켜 두어야 분실되지 않는다.

(적용모델: DUO-35/20)

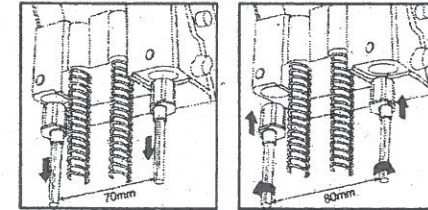


- 커버 뒷부분의 고무캡을 손으로 빼낸 후 나사를 드라이버로 해제한다.
- 펀치홀더의 전면부에 있는 나사를 육각렌치로 돌려 풀면 천공침이 해제된다.
- 천공침용치의 나사를 한번 더 육각렌치로 돌려 풀면 천공침이 해제된다.
- 침교체를 육각렌치는 우측그림과 같이 칩박스의 안쪽에 고정되어 있으므로 사용 후 팔이 권위처에 고정시켜 두어야 분실되지 않는다.

2) 천공 및 제본간격 변경(70→80mm) (적용모델: DUO-35/20)

① 천공간격 변경

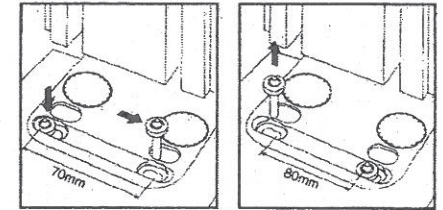
- 간격 70mm 간격의 천공간격에서 80mm 간격으로, 혹은 이와 반대로 천공간격 및 제본간격을 변경 하도록 할 때



- 펀치홀더의 전면부에 있는 나사를 툄 후 좌우 2개의 천공침용치를 각각 빼낸 후 이를 80° 회전시켜 다시 결합 고정 시키면 천공간격이 변경된다.

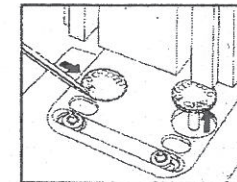
② 제본간격 변경

- 천공간격이 바뀌게 됨에 따라 제본리벳팅간격도 함께 변경 되어야 한다.



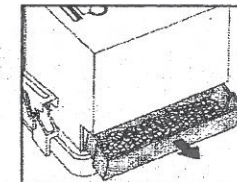
- 와셔 고정홈에 있는 양측 리벳다이들 각각 위로 빼내어 바로 옆의 구멍에 꽂으면 제본간격이변경된다.

3) 천공패드의 사용법 및 교체방법



- 천공패드도 고정된 위치에서 정사각 사용하게 되면 천공자국이 많이 때어 천공능력이 떨어지게 된다. 이때는 천공패드를 불렛 등으로 수시로 조금씩 회전시켜 사용하면 좋으며, 마모가 심하면 새것으로 교체한다. 교체시에는 기계 밑에서 천공패드를 밀어 요기(가)로 옮기면 된다.

4) 칩배출



- 커버 뒷부분의 칩박스를 자주 빼내어 칩을 제거해 주어야 한다. 칩박스에 천공침이 많이 쌓이게 되면 천공 작업이 되지 않을 경우도 있다.